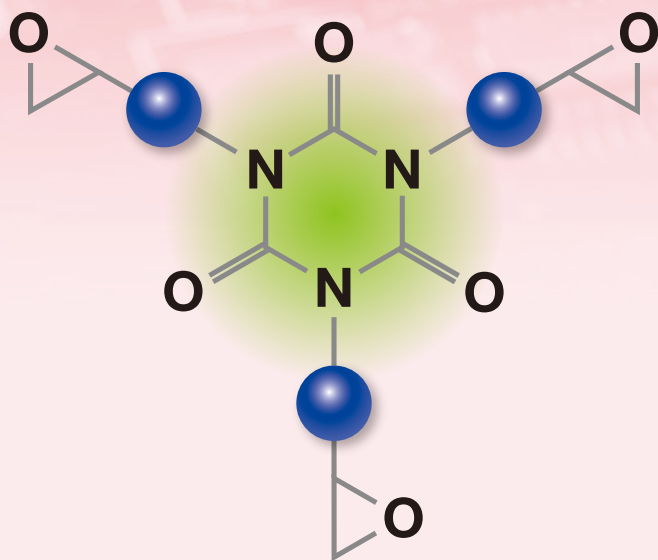


Cationic curable cross-linker

易溶性・高カチオン性反応性エポキシ架橋剤

TEPIC[®]-FL



■ 特長 Characteristics

低粘度

Low Viscosity

低吸水性

Low water absorbency

カチオン硬化性

Cationic curable

高伸び率

High elongation

■ TEPIC[®]-FL 外観 Appearance



■ TEPIC[®]-FL 物性 Monomer property

項目 Unit	Property
性状 Appearance	Colorless, Clear
粘度 Viscosity	Approx. 800 mPa·s
エポキシ当量 EEW	165-185 g/eq.
液密度 Density	1.08 g/cm ³
良溶媒 Good solvent (Soluble, 50wt.% or more)	Methanol PGMEA Toluene PGME MIBK Cyclohexanone

TEPIC®-FLの硬化 Several curing method of TEPIC®-FL

■ 硬化物 物性一覧 Property of Cured material with Carboxylic acid anhydride

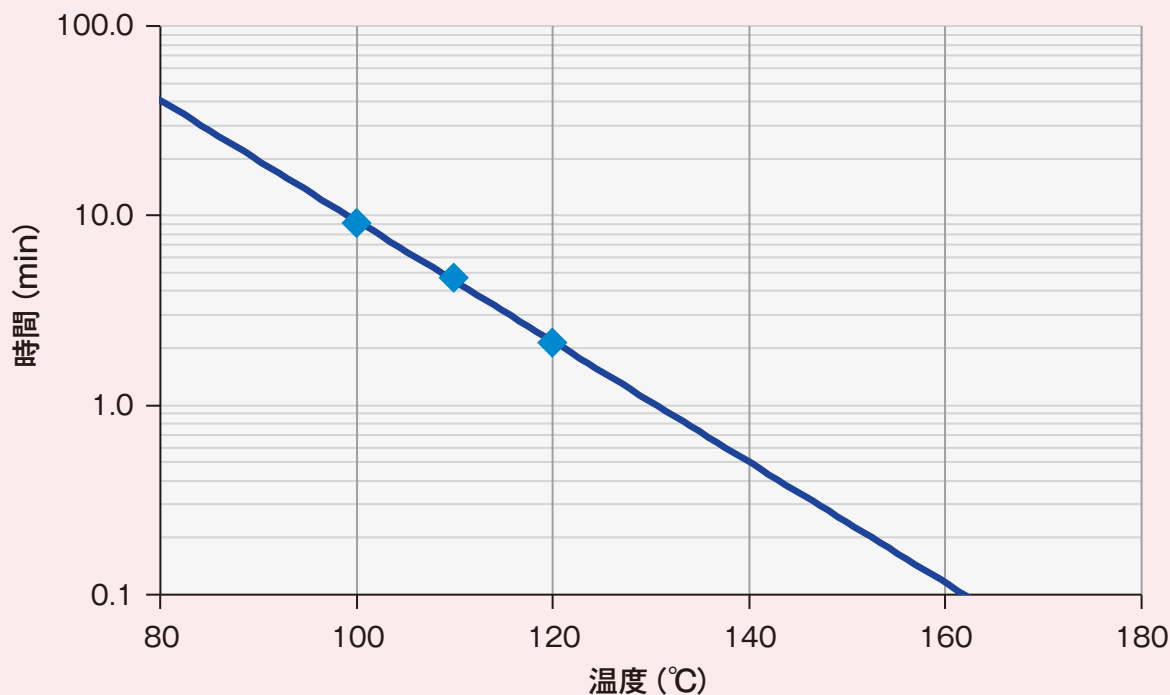
項目 Unit	Property
Tg Glass transition temperature	116°C (measured by DMA)
透過率 Transmittance	98.4% (@400 nm, 200 μm-thick)
曲げ弾性率 Flexural modulus	2,200 MPa
曲げ撓み Flexural length	29 mm
誘電率 Dielectric constant	3.05
硬化収縮率 Curing shrinkage	2.9%
煮沸吸水率 Water Absorption	1.7% (100°C for 100h) *TEPIC 4.51%

〈硬化条件〉
 硬化剤：リカシッドMH-700 (新日本理化株式会社)
 硬化促進剤：ヒシコーリンPX-4ET (日本化学工業株式会社)
 硬化プロセス：100°C/2h → 150°C/5h

〈Curing condition〉
 Hardener: RIKACID MH-700 (New Japan Chemical Co.,LTD.)
 Accelerator: HISHIKOLIN PX-4ET
 (Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd.)
 Curing condition: 100°C/2h → 150°C/5h

■ 熱カチオン硬化性 Curing behavior at thermal cationic polymerization

〈各温度におけるゲル化時間〉



〈熱カチオン開始剤〉
 サンエイドSI-100 (三新化学工業株式会社), 1phr

〈Thermal acid generator〉
 San-Aid SI-100 (Sanshin Chemical Industry Co., LTD.), 1phr



日産化学株式会社

〒103-6119 東京都中央区日本橋2-5-1
 日本橋高島屋三井ビルディング

化学品事業部 ファインケミカル営業部

TEL: 03-4463-8151 FAX: 03-4463-8138
 URL: <http://www.nissanchem.co.jp>